

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-046

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“芯碁微装”或“公司”)董事会对 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]350 号)的批准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,020.2448 万股,募集资金总额人民币 459,983,283.04 元,募集资金净额为人民币 416,358,195.95 元。上述资金已于 2021 年 3 月 29 日全部到位,并存放于公司开设的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《合肥芯碁微电子装备股份有限公司验资报告》(容诚验字【2021】230Z0034 号)。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息共计人民币 13,792,202.76（含活期利息）元，已使用募集资金金额为人民币 305,784,341.77 元，本年度已使用募集资金金额为人民币 56,902,426.94 元，现金管理理财结算户余额为人民币 0 元，募集资金存储账户余额为人民币 0 元（含活期利息）。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

公司、保荐机构海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行、中信银行合肥分行营业部、中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行、中国农业银行合肥分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十七次会议、2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》和《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金部分投资项目“高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，同时公司在履行相关审议程序后对募集资金进行了现金管理，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）

的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金 5,582.40 万元用于永久补充公司流动资金。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金 56,902,426.94 元，具体募集资金使用情况见附表。

募投项目实际投资进度与投资计划不存在显著差异，也不存在无法单独核算效益的情形。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换。报告期内公司不涉及对预先投入募投项目的自筹资金的置换的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的公司第一届董事会第十七次会议、2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过

10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过 12 个月。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：元

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入金额	投资期限	期末余额	利息金额
1	杭州银行	大额存单	50,000,000.00	50,000,000.00	2020.9.24-2023.9.24	0	2,937,698.63
2	杭州银行	大额存单	60,000,000.00	60,000,000.00	2022.2.25-2025.2.25	0	1,633,972.61
3	杭州银行	大额存单	10,000,000.00	60,000,000.00	2022.2.24-2025.2.24	0	87,534.25
4	杭州银行	大额存单	20,000,000.00	20,000,000.00	2022.12.26-2024.8.10	0	262,602.74
合计			140,000,000.00	140,000,000.00		0	4,921,808.23

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无此种情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无此种情形。

（七）节余募集资金使用情况

经 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议，并经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目“高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

经 2023 年 5 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事

会第六次会议审议，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年4月27日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，于2022年5月18日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目“高端PCB激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司将该项目节余募集资金6,849.44万元（包含利息收入扣除银行手续费后净额437.92万元）永久性补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已对该募集资金专户办理注销手续。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。

公司于2023年5月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司将该项目节余募集资金5,582.40万元用于永久性补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已对该募集资金专户办理注销手续。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			416,358,195.95			本年度投入募集资金总额			56,902,426.94			
变更用途的募集资金总额			110,573,854.18			已累计投入募集资金总额			305,784,341.77			
变更用途的募集资金总额比例 (%)			26.56%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本项目已实现的效益或者研发成果	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端 PCB 激光直接成像(LDI)设备升级迭代项目	无	207,700,000.00	207,700,000.00	207,700,000.00	0	143,584,834.29	-64,115,165.71	69.13	2022年3月	NEX60、NEX50、NEX40 产品量产;MAS8 已完成多台验收;MAS6 出货到海	是	否

										外； 获批 4 个发明专利，均为实审阶段		
晶圆级封装 (WLP)直写光刻设备产业化项目	无	93,800,000.00	58,800,000.00	58,800,000.00	6,148,513.04	42,929,014.89	-15,870,985.11	73.01	2023年5月	WLP 已经出货到客户端；获批 2 个发明专利，均为实审阶段。获批一个实用新型专利，为受理阶段。	是	否
平板显示 (FPD)光刻设备研发项目	无	108,360,000.00	8,6308,195.95	8,6308,195.95	20,182,545.12	69,852,166.85	-16,456,029.10	80.93	2023年5月	镜头离线装调系统、平台位置精度 mapping 系统等已在装调过程中应用 FPD-G6 已在客户端测试；新申请 1 个发明专利，实审阶段，	是	否

										新申请 2 个实用新型专利，授权阶段；8 个发明专利由实审阶段转为授权		
微纳制造技术研发中心建设项目	无	63,550,000.00	63,550,000.00	63,550,000.00	30,571,368.78	49,418,325.74	-14,131,674.26	77.76	2023 年 5 月	研发中心系统实验室、光学实验室、机电实验室、数据链路实验室、激光器实验室建设；关键模块和项目有：大功率激光器（百 W 级）、软件开发项目、高精度高速链路研发；主动聚焦项目等；获批 2 个发	是	否

										明专利，实 审阶段。获 批 1 个实用 新型专利， 授权阶段。		
合计	-	473,410,0 00.00	416,358,19 5.95	416,358,19 5.95	56,902,4 26.94	305,784, 341.77	-110,573 ,854.18	73.44	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”的预定可使用状态延期由 2023 年 2 月延至 2023 年 5 月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2021 年 6 月 15 日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,884.91 万元置换预先投入的募投项目及已支付发行费用的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至报告期末，公司首发募投项目已全部结项，公司闲置募集资金投资相关产品已全部赎回，公司现金管理理财结算户募集资金余额为 0 元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。2、因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司对短期内出现的部分闲置募集资金进行了现金管理，有效提高了募资金的使用效率，增加了公司收益。								
募集资金其他使用情况				不适用								